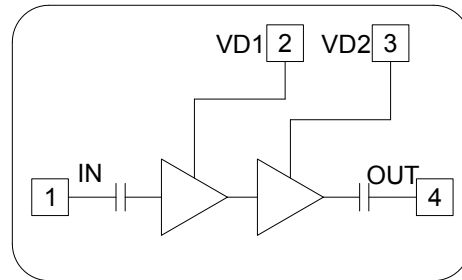


特点:

- 频率: 6~20GHz
- 增益: 30dB
- 输出 P-1dB 压缩点: 17dBm
- 工作电压电流: +5V@85mA
- 工作温度: -55~+85℃
- 芯片尺寸: 1.88×0.78×0.1mm

功能框图

性能参数: (T_A=+25℃, V_D=+5V, I_D=85mA)

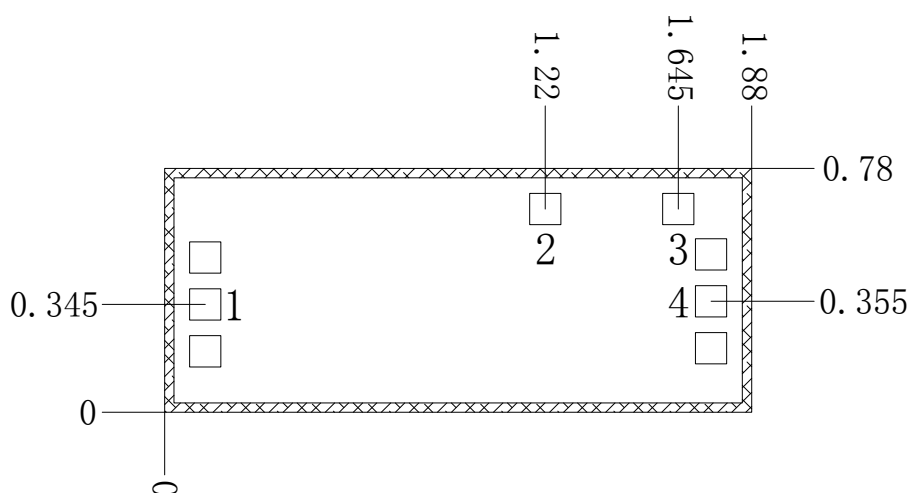
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	V _D =+5.0V Z _{in} =Z _{out} =50Ω	6		20	GHz	
增益	G		27	30		dB	
输入驻波	VSWR _i			2	3		
输出驻波	VSWR _o				1.5	2	
噪声系数	NF				2	4	dB
输出 P ₋₁	P ₋₁			15	17		dBm
电压	V _D			4.75	5	5.25	V
电流	I _D	V _D =+5.0V		85	100	mA	

极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
最大输入电压	+5.5	V	贮存温度	-55~+150	℃

芯片尺寸图:

单位: mm

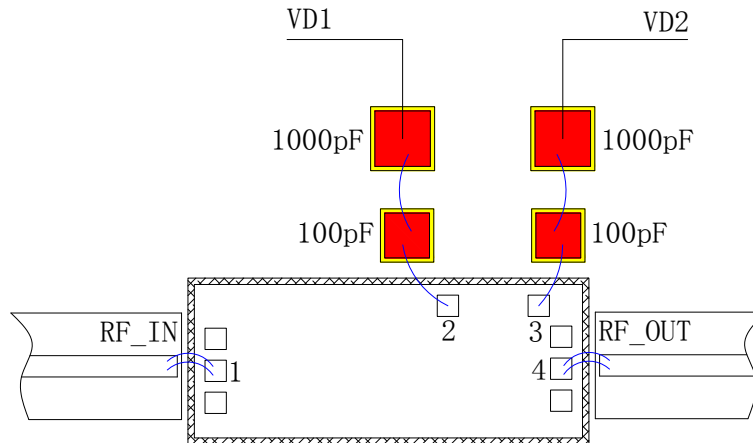


注: 典型键合焊盘尺寸为 100*100um

引脚定义:

引脚	定义	描述
1	IN	射频输入, AC 耦合
2, 3	VD1, VD2	放大器电源电压, 需外接 100pF 和 1000pF 旁路电容
4	OUT	射频输出, AC 耦合
芯片背面	GND	芯片背面必须接至 RF/DC 地

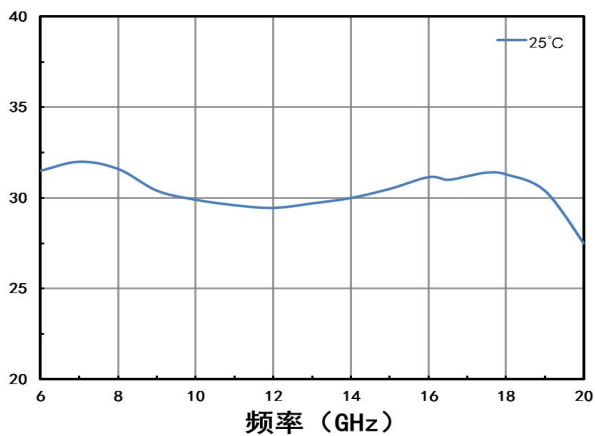
推荐装配图:



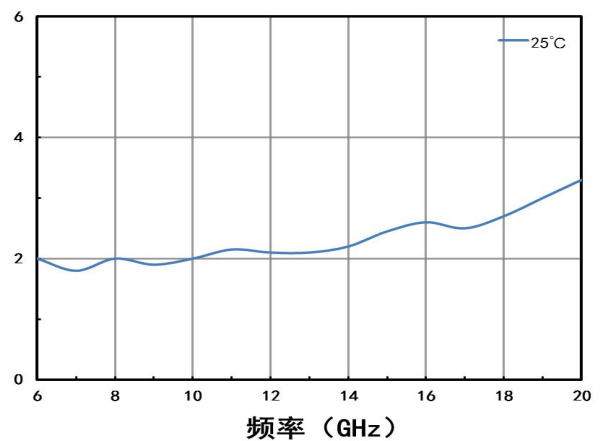
注: 未标注的键合焊盘不需要连接

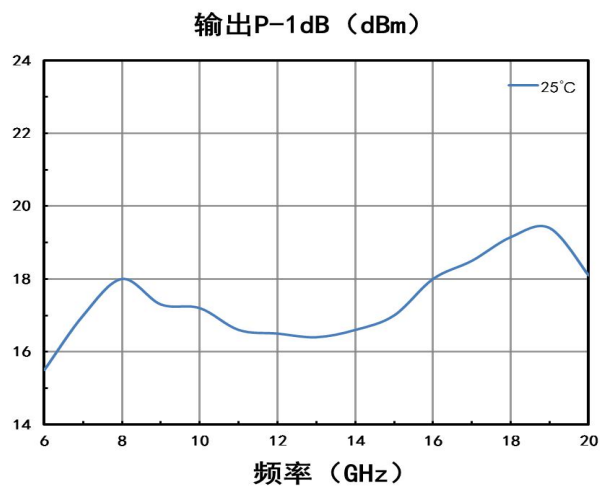
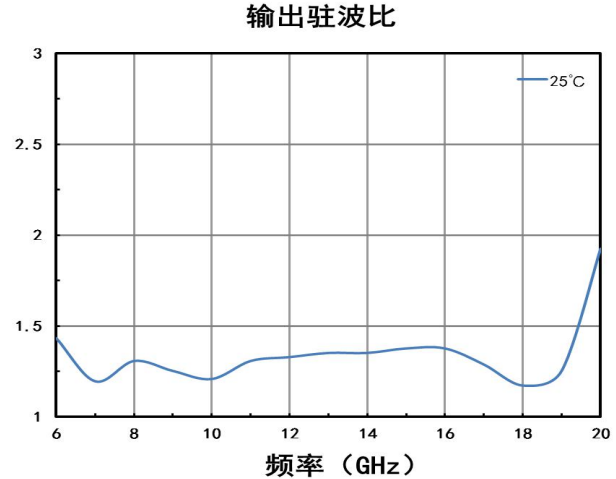
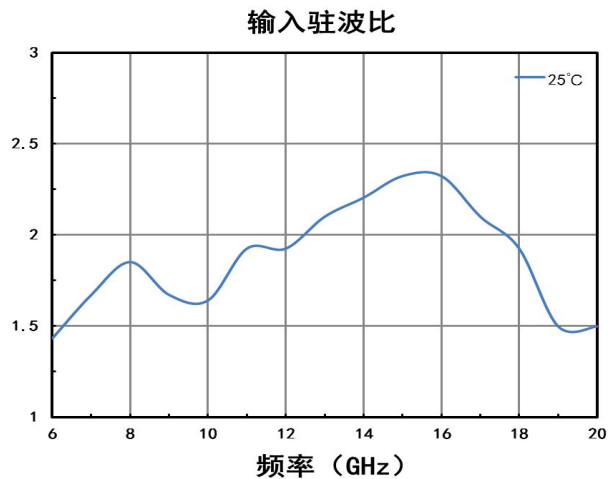
典型测试曲线:

增益 (dB)



噪声系数 (dB)





产品使用注意事项:

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用；
2. 裸芯片使用的 GaAs 材料较脆，芯片表面容易受损，不能用干或湿化学方法清洁芯片表面使用时必须小心；
3. 芯片底部用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 295°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与微带线间歇不超过 3 mil，使用 1 mil 双金丝键合，其他端口使用 1 mil 单金丝，建议金丝长度 10~16 mil；
5. 产品对静电敏感，在存储和使用过程中注意防静电；
6. 其他使用说明详见《裸芯片产品使用说明》。